

Title (en)

Process and apparatus for manufacturing a wire

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines Drahtes

Title (fr)

Procédé et dispositif de fabrication d'un fil

Publication

**EP 1126050 A1 20010822 (DE)**

Application

**EP 01103006 A 20010208**

Priority

DE 10007567 A 20000218

Abstract (en)

[origin: CA2332689A1] In a method for manufacturing a wire, particularly a sawtooth wire for all-steel sawtooth wire card clothings, in which the surface of a wire-shaped intermediate product, such as a wire already provided with sawteeth, is smoothened in an electropolishing process in an electrolyte bath containing an electrolyte, a further development is proposed in which a relative movement is produced between the electrolyte and the intermediate product during the electropolishing process.

Abstract (de)

Bei einem Verfahren zum Herstellen eines Drahtes, insbesondere Sägezahndrahtes für Sägezahn-Ganzstahlgarnituren bei denen die Oberfläche eines drahtförmigen Zwischenproduktes, wie etwa eines bereits mit Sägezähnen versehenen Drahtes in einem Elektrolyten enthaltenden Elektrolytbad mit einem Elektropoliervorgang geglättet wird, wird eine Weiterbildung vorgeschlagen, bei der während des Extrapoliervorganges eine Relativbewegung zwischen dem Elektrolyten und dem Zwischenprodukt erzeugt wird.

IPC 1-7

**C25F 7/00**; D01G 15/88

IPC 8 full level

**C25F 7/00** (2006.01); **D01G 15/84** (2006.01); **D01G 15/88** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**C25F 7/00** (2013.01 - EP US); **D01G 15/84** (2013.01 - EP US); **D01G 15/88** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [X] US 4612084 A 19860916 - SCHMOLKE KARL-HEINZ [DE]
- [X] US 3676322 A 19720711 - KAMATA YOSHIHIRO, et al
- [X] EP 0561522 A1 19930922 - GEN ELECTRIC [US]

Cited by

EP1850993B1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

DOCDB simple family (publication)

**EP 1126050 A1 20010822**; **EP 1126050 B1 20050907**; AR 027915 A1 20030416; AT E304068 T1 20050915; AU 1835001 A 20010823; AU 761171 B2 20030529; BR 0100605 A 20011009; CA 2332689 A1 20010818; DE 10007567 A1 20010830; DE 10007567 C2 20030807; DE 50107322 D1 20051013; ES 2246261 T3 20060216; JP 2001248000 A 20010914; TW 593793 B 20040621; US 2001015323 A1 20010823; US 6544402 B2 20030408

DOCDB simple family (application)

**EP 01103006 A 20010208**; AR P010100036 A 20010104; AT 01103006 T 20010208; AU 1835001 A 20010208; BR 0100605 A 20010216; CA 2332689 A 20010129; DE 10007567 A 20000218; DE 50107322 T 20010208; ES 01103006 T 20010208; JP 2001036354 A 20010214; TW 90103224 A 20010219; US 78423601 A 20010214